

# 2016-2022年中国手机芯片市场发展现状及战略咨询报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2016-2022年中国手机芯片市场发展现状及战略咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/189030.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

手机芯片是IC的一个分类，是一种硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中最重要的部分，承担着运算和存储的功能。

手机芯片通常是指应用于手机通讯功能的芯片，包括基带、处理器、协处理器、RF、触摸屏控制器芯片、Memory、处理器、无线IC和电源管理IC等。目前主要手机芯片平台有MTK、ADI、TI、AGERE、ST-NXP

Wireless、INFINEON、SKYWORKS、SPREADTRUM、Qualcomm等。

国产机GSM系列手机主要可分为MTK、ADI、TI、AGERE、PHILIPS、INFINEON、SKYW ORKS、SPREADTRUM八大平台：

### 一、MTK芯片（台湾联发科技公司Media Tek .Inc）

1. MTK芯片是MTK（台湾联发科技公司Media Tek .Inc）的系列产品，MTK的平台适用于中低端，基带比较集成。现国内大部机用其芯片，尤其是带MP3 MP4的起码70%是使用MTK芯片。

2.

基带芯片主要有：MT6205、MT6217、MT6218、MT6219、MT6226、MT6227、MT6228 MT6205为最早的方案，只有GSM的基本功能，不支持GPRS、WAP、MP3等功能(2003年MP)。

MT6218为在MT6205基础上增加GPRS、WAP、MP3功能。MT6217为MT6218的cost down方案，与MT6128PIN

TO

PIN，只是软件不同而已，另外MT6217支持16bit数据（2004年MP）。

MT6219为MT6218上增加内置AIT的1.3Mcamera处理IC，增加MP4功能。8bit数据（2005年MP）。

MT6226为MT6219 cost down产品，内置0.3Mcamera处理IC，支持GPRS、WAP、MP3、MP4等，内部配置比MT6219优化及改善，比如配蓝牙是可用很便宜的芯片CSR的BC03模块USD3即可支持数据传输（如听立体声MP3等）功能。

MT6226M为MT6226高配置设计，内置的是1.3Mcamera处理IC（2006年MP）。

MT6227与MT6226功能基本一样，PIN

TO

PIN，只是内置的是2.0Mcamera处理IC（2006年MP）。

MT6228比MT6227增加TVOUT功能，内置3.0Mcamera处理IC，支持GPRS、WAP、MP3、MP4（2006年MP）。

从MT6226后软件均可支持网络摄像头功能，也就是说手机可以用于QQ视频；

3. 电源管理芯片有：MT6305、MT6305B

4. RF芯片有：MT6119、MT6129

5.

PA芯片有：RF3140

、RF3146 (7x7mm)、RF3146D (双频)、RF3166 (6x6mm)

6. 采用MT芯片的手机有：联想、天阔、普天、三新、三盟、宇宙、南方高科、诺科、康佳、科健、采星、迷你、波导、CECT、TCL、奥克斯、东信、长虹、托普、吉事达等。

## 二、ADI芯片 (美国模拟器件公司Analog Devices Inc)

1. ADI芯片是ADI (美国模拟器件公司Analog Devices Inc) 的系列产品,在国产的二线杂牌手机厂商中较常见。

2. 基带芯片、复合模拟信号处理IC、电源管理芯片：

AD6522, ADI的第一代GSM处理器, 与之配对的复合模拟信号处理IC是产品AD6521, 电源管理有AD3402、AD3404、AD3408 (有两种封装) 等；

AD6525、AD6526, ADI的第二代GSM处理器, 引脚采用向上兼容, 即与AD6522一样。AD6525、AD6526与AD6522相比最大的特点是增加了对GPRS的支持。还有一个必须注意的是, 它的内核供电电压与AD6522不同, AD6522的内核供电电压是2.40V ~

2.75V, 而AD6525、AD6526的内核供电电压是1.7V ~ 1.9V。所以, 如果AD6525采用对应的复合模拟信号处理IC是AD6521, 必须采用AD3522电源管理IC。除了采用AD6521、AD3522配对IC外, ADI推荐使用AD6533、AD6535或AD6537复合模拟信号处理IC；

第三代的基带处理器有：AD6527、AD6528、AD6529, 因为增加了对USB的支持, 需要USB引脚, 所以在引脚上无法与第一代AD6522, 第二代AD6526、AD6526兼容。配对IC使用AD6533、AD6535或AD6537复合模拟信号处理IC；

另外还有一个AD6527+AD6535的复合片基带单芯片处理器：AD6720。大家可以看到, AD6527+AD6535就是ADI芯片组的逻辑部分的芯片, 所以它就是逻辑部分的所有功能集成到一个芯片上低成本基带处理器。此外, ADI还有支持EDGE的芯片组, 基带处理器是AD6532, 采用的复合IC是AD6555以及还有功能强大, 支持媒体应用的基带处理器AD6758。

3. RF芯片:由于各手机厂商的设计思路有所不同, 因此一部分采用了ADI的逻辑和射频 (中频IC AD6523和频率合成器AD6524) 整套芯片, 另一部分仅采用了ADI的逻辑芯片组, 而RF芯片则采用其他公司的芯片。

4. 用ADI芯片的手机有：波导、南方高科、东信、联想、夏新、大显、科健、宝石、搜豹、美晨、海尔、采星、中兴ZTE、TCL、金立等。

## 三、TI芯片(美国德州仪器公司TEXAS INSTRUMENTS)

1. I芯片是TI(美国德州仪器公司TEXAS INSTRUMENTS)的系列产品。

2. TI芯片组合主要有三套：一是ULYSSE+OMEGA;二是CALYPSO+IOTA;三是OMAP系列, 其中OMAP系列较新。

ULYSSE型号：F741529AGHH D741979BGHH等 (74系列)；

CALYPSO型号：PD751774GHH PD751992GHH等 (75系列)；

OMAP系列型号:OMAP310 OMAP1510 OMAP1610 OMAP1611 OMAP1612OMAP710 OMAP730 OMAP732。

电源中综合管理芯片 (OMEGA/IOTA) :TWL3011 TWL3012 TWL3014 TWL3016  
TWL3025TWL3029

3. RF芯片：采用TRF、PMB、RTF、HD、PCF、SI等芯片。

4. 用TI芯片的手机有：TCL、夏新、海尔、南方高科、康佳、波导、星王、东信、中兴、联想、摩托罗拉、松下、多普达、喜多星等。

#### 四、AGERE芯片 (美国杰尔公司)

1. AGERE芯片是AGERE SYTEMS (美国杰尔公司) 的系列产品。

2. AGERE芯片组合主要有二套：一是TR09WQTE2B(中央处理器)+CSP1093CR1 (音频)+PSC2006HRS(电源)；二是TRIBENT-2(中央处理器)+CSP1099 (音频)+PSC2010B(电源)。

3. 用AGERE芯片的手机有：三星、夏新、东信、康佳、帕玛斯等。

#### 五、PHILIPS芯片 (荷兰飞利浦公司)

1. PHILIPS芯片是PHILIPS (荷兰飞利浦公司) 的系列产品。

2. PHILIPS芯片主要有两类：VLSI系列 (也称VP系列) 和SYSOL系列 (也称OM系列)，其中SYSOL系列 (也称OM系列) 也是国产杂牌机的选择方案。

3. SYSOL系列 (也称OM系列) 芯片：

电源管理单元 (PMU) :PCF50601、PCF50603、PCF50604、UBA8073

中央处理器 (CPU) :OM6353、OM6354、OM6357、OM6359、PCF5123

射频IC : OM5178、UAA3536、UAA3587

4. 用PHILIPS芯片的手机有：三星、桑达、迪比特、海尔、康佳、联想、波导等。

#### 六、INFINEON芯片 (德国英飞凌公司)

1. INFINEON芯片是INFINEON (德国英飞凌公司) 的系列产品。

2. INFINEON芯片：

基带芯片：PMB7850、PMB7870、PMB6850、PMB6851、PMB2800

电源芯片：PMB6510

射频IC：PMB6250、PMB6256

3. 用INFINEON芯片的手机有：波导、西门子、康佳、天时达、金立等。

#### 七、SKYWORKS芯片 (美国科胜讯公司)

1. SKYWORKS芯片是美国CONEXANT SYSTEM  
INC (美国科胜讯公司) 开发的系列产品。

2. SKYWORKS芯片：

中央处理器 (CPU) : M4641、CX805和CX80501

射频IC : CX74017

3. 用SKYWORKS芯片的手机：三星、桑达、康佳、波导、联想、松下、西门子等。

#### 八、SPREADTRUM芯片 展讯通信 (上海)

- 1.SPREADTRUM芯片是展讯通信（上海）有限公司开发的产品。
2. 基带芯片：SC6600、SC6800、SC8800，目前用于手机的主要是SC6600。
3. 基带芯片SC6600主要功能简介：

LDO电源管理

四频GSM/GPRS（850/900/1800/1900）

内置MIDI格式的64和弦

内置MP3播放器

支持百万像素数码拍照

支持U盘

支持MMC/SD卡

支持蓝牙

4. 用SPREADTRUM芯片的手机：金立、波导、托普、猎星、高科、CECT等。

手机客户端软件开发最大的困难就是平台不统一，手机开发平台太多。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 中国手机芯片行业宏观环境分析

第一节 手机芯片行业定义分析

一、行业定义

二、行业产品分类

第二节 手机芯片行业宏观环境分析

一、政策环境

二、经济环境

三、技术环境

四、社会环境

第二章 全球手机芯片行业现状及发展预测分析

第一节 全球手机芯片行业概述

第二节 全球手机芯片行业市场格局分析

一、全球手机芯片贸易动向分析

二、全球手机芯片生产概况

三、国内外手机芯片生产模式及效益

第三节 全球手机芯片产业主要国家运行形势分析

一、美国

## 二、欧洲

## 三、日本

### 第四节 2016-2022年全球手机芯片产业市场走势预测分析

## 第三章 2012-2015年中国手机芯片行业经济指标分析

### 第一节 2012-2015年手机芯片行业发展概述

#### 第二节 2012-2015年手机芯片行业经济运行状况

##### 一、手机芯片行业企业数量分析

##### 二、手机芯片行业资产规模分析

##### 三、手机芯片行业销售收入分析

##### 四、手机芯片行业利润总额分析

#### 第三节 2012-2015年手机芯片行业成本费用分析

##### 一、手机芯片行业销售成本分析

##### 二、手机芯片行业销售费用分析

##### 三、手机芯片行业管理费用分析

##### 四、手机芯片行业财务费用分析

#### 第四节 2012-2015年手机芯片行业运营效益分析

##### 一、手机芯片行业盈利能力分析

##### 二、手机芯片行业运营能力分析

##### 三、手机芯片行业偿债能力分析

##### 四、手机芯片行业成长能力分析

## 第四章 中国手机芯片行业市场竞争分析

### 第一节 手机芯片行业上下游市场分析

#### 一、手机芯片行业产业链简介

##### 二、上游市场供给分析

##### 三、下游市场需求分析

### 第二节 手机芯片行业市场供需分析

#### 一、手机芯片行业生产总量

#### 二、手机芯片行业市场总量

##### 1、市场需求总量

##### 2、各产品市场容量及变化

##### 三、手机芯片行业产品价格分析

### 第三节 手机芯片行业竞争力分析

#### 一、上游议价能力分析

#### 二、下游议价能力分析

#### 三、替代品威胁分析

#### 四、新进入者威胁分析

#### 五、行业竞争现状分析

#### 第四节 手机芯片行业市场集中度分析

##### 一、行业市场集中度分析

##### 二、行业主要竞争者分析

#### 第五章 中国手机芯片行业传统商业模式分析

##### 第一节 手机芯片行业原料采购模式

##### 第二节 手机芯片行业经营模式

##### 第三节 手机芯片行业盈利模式

##### 第四节 OEM、ODM、OBM模式分析

#### 第六章 中国手机芯片行业商业模式构建与实施策略

##### 第一节 手机芯片行业商业模式要素与特征

##### 一、商业模式的构成要素

##### 二、商业模式的模式要素

###### 1、产品价值模式

###### 2、战略模式

###### 3、市场模式

###### 4、营销模式

###### 5、管理模式

###### 6、资源整合模式

###### 7、资本运作模式

###### 8、成本模式

###### 9、营收模式

##### 三、成功商业模式的特征

##### 第二节 手机芯片行业企业商业模式构建步骤

##### 一、挖掘客户价值需求

###### 1、转变商业思维

###### 2、客户隐性需求

###### 3、客户价值主张

##### 二、产业价值链再定位

###### 1、客户价值公式

###### 2、产业价值定位

###### 3、商业形态定位

##### 三、寻找利益相关者

##### 四、构建盈利模式



### 第三节 手机芯片行业商业模式的实施策略

#### 一、企业价值链管理的目标

- 1、高效率
- 2、高品质
- 3、持续创新
- 4、快速客户响应

#### 二、企业价值链管理系统建设

- 1、组织结构系统
- 2、企业控制系统

#### 三、企业文化建设

### 第七章 中国手机芯片行业商业模式创新转型分析

#### 第一节 互联网思维对行业的影响

- 一、互联网思维三大特征
- 二、基于互联网思维的行业发展

#### 第二节 互联网时代七大商业模式

##### 一、平台模式

- 1、构成平台模式的6个条件
- 2、平台模式的战略定位
- 3、平台模式成功的四大要素
- 4、平台模式案例

##### 二、免费模式

- 1、免费商业模式解析
- 2、免费战略的实施条件
- 3、免费战略的类型

- (1) 产品模式创新型
- (2) 伙伴模式创新型
- (3) 族群模式创新型
- (4) 渠道模式创新型
- (5) 沟通模式创新型
- (6) 客户模式创新型
- (7) 成本模式创新型
- (8) 壁垒模式创新型

##### 三、软硬一体化模式

- 1、软硬一体化商业模式案例
- 2、软硬一体化模式受到市场追捧

3、软硬一体化模式是一项系统工程

4、成功打造软硬一体化商业模式的关键举措

四、O2O模式

1、O2O模式爆发巨大力量

2、O2O模式分类

3、O2O模式的盈利点分析

4、O2O模式的思考

五、品牌模式

1、品牌模式的内涵及本质

2、成功的移动互联网品牌

3、如何推进品牌经营

六、双模模式

1、双模模式概述

2、移动互联网：用户规模是关键

3、双模模式案例

七、速度模式

1、什么是速度模式

2、速度模式的主要表现

3、速度模式应注意的几个问题

第三节 互联网背景下手机芯片行业商业模式选择

一、手机芯片行业与互联网思维的结合

二、互联网背景下手机芯片行业商业模式选择

第八章 2012-2015年中国手机芯片进出口数据监测分析

第一节 2012-2015年中国手机芯片进口数据分析

一、进口数量分析

二、进口金额分析

第二节 2012-2015年中国手机芯片出口数据分析

一、出口数量分析

二、出口金额分析

第三节 2012-2015年中国手机芯片进出口平均单价分析

第四节 2012-2015年中国手机芯片进出口国家及地区分析

一、进口国家及地区分析

二、出口国家及地区分析

第九章 2015年手机芯片行业企业经营情况与商业模式分析

第一节 企业一

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业经营模式分析

六、企业发展战略规划

## 第二节 企业二

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业经营模式分析

六、企业发展战略规划

## 第三节 企业三

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业经营模式分析

六、企业发展战略规划

## 第四节 企业四

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业经营模式分析

六、企业发展战略规划

## 第五节 企业五

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业经营模式分析

六、企业发展战略规划

## 第十章 2016-2022年中国手机芯片行业发展前景预测分析

## 第一节 2016-2022年手机芯片行业发展前景及趋势预测分析

### 第二节 2016-2022年手机芯片行业发展前景预测

- 一、2016-2022年手机芯片行业生产规模预测
- 二、2016-2022年手机芯片行业市场规模预测
- 三、2016-2022年手机芯片行业盈利前景预测

## 第十一章 手机芯片行业投资分析与预测

### 第一节 行业投资特性分析

- 一、行业进入壁垒分析
- 二、盈利模式分析
- 三、盈利因素分析

### 第二节 行业投资风险分析

- 一、投资政策风险分析
- 二、投资技术风险分析
- 三、投资供求风险分析
- 四、宏观经济波动风险

### 第三节 专家行业投资机会与建议

- 一、行业投资机会分析
- 二、行业主要投资建议

### 第四节 行业发展趋势与预测分析

- 一、发展趋势分析
- 二、发展前景预测
  - 1、生产规模预测
  - 2、市场容量预测
  - 3、销售收入预测

## 第十二章 2016-2022年中国手机芯片行业投融资战略规划分析

### 第一节 手机芯片行业关键成功要素分析

### 第二节 手机芯片行业投资壁垒分析

- 一、手机芯片行业进入壁垒
- 二、手机芯片行业退出壁垒

### 第三节 手机芯片行业投资风险与规避

- 一、宏观经济风险与规避
- 二、行业政策风险与规避
- 三、原料市场风险与规避
- 四、市场竞争风险与规避
- 五、技术风险分析与规避

## 六、下游需求风险与规避

### 第四节 手机芯片行业融资渠道与策略

#### 一、手机芯片行业融资渠道分析

#### 二、手机芯片行业融资策略分析(AK HT)

图表目录：

图表：2012-2015年手机芯片行业企业数量分析

图表：2012-2015年手机芯片行业资产规模分析

图表：2012-2015年手机芯片行业销售收入分析

图表：2012-2015年手机芯片行业利润总额分析

图表：手机芯片行业"波特五力"分析

图表：生命周期各发展阶段的影响

图表：2016-2022年手机芯片产品消费预测

图表：2016-2022年手机芯片市场规模预测

图表：2016-2022年手机芯片行业总产值预测

图表：2016-2022年手机芯片行业销售收入预测

图表：2016-2022年手机芯片行业总资产预测

图表：2016-2022年中国手机芯片供给量预测

图表：2016-2022年中国手机芯片产量预测

图表：2016-2022年中国手机芯片需求量预测

图表：2016-2022年中国手机芯片供需平衡预测

图表：手机芯片行业新进入者应注意的障碍分析

图表：2016-2022年影响手机芯片行业运行的有利因素

图表：2016-2022年影响手机芯片行业运行的稳定因素

图表：2016-2022年影响手机芯片行业运行的不利因素

图表：2016-2022年我国手机芯片行业发展面临的挑战

图表：2016-2022年我国手机芯片行业发展面临机遇

图表：2016-2022年手机芯片行业经营风险及控制策略

图表：2016-2022年手机芯片行业同业竞争风险及控制策略

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/189030.html>